

# INVESTOR RELATIONS | FY 2026

## Third Quarter Earnings

# CONTENTS


01 Company Overview

02 Business Overview

03 Financial Result

04 Appendix

# Disclaimer

본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 따라서 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것으로 당사는 이 자료의 내용에 대하여 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

# 01. Company Overview

Create Future!

TES

Technology Engine of Science

# 01 Company Overview

## Overview

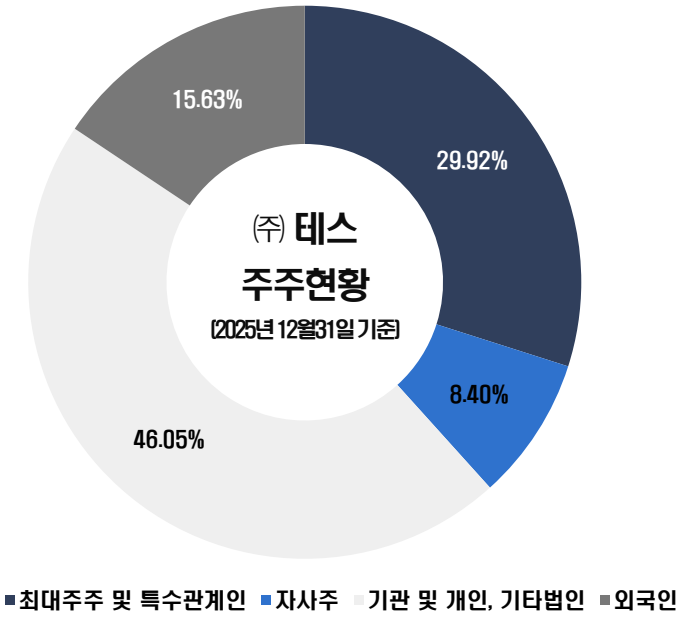








| | |
|---|---|
| 회 사 명 | ㈜ 테스 |
| 설 립 일 | 2002.09.19 |
| 본 사 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 |
| 대표이사 | 이재호, 주재영 |
| 자본금 | 9,884 백만원 |
| 임직원수 | 472명(2026.06.30) |
| 홈페이지 | www.hites.co.kr |
| 주요사업 | 반도체, 디스플레이, 화합물반도체 장비 제조업 |
| 상장정보 | KOSDAQ (상장일 : 2008.5.20 / Code: 095610 ) |



# 01 Company Overview

## History

**2002 ~ 2006**

- **2002.09 ㈜테스 설립**
- 2004.10 본사이전 (주소: 용인시 처인구 양지면)
- 2005.04 300mm PE-CVD(반도체用) 개발

**2007 ~ 2011**

- **2008.05 코스닥(KOSDAQ) 상장**
- 2010.12 PECVD ACL장비 세계일류상품 선정

**2012 ~ 2016**

- **2012.04 반도체 GPE(Gas Phase Etcher)양산**
- 2013.10 300mm 장비 100호기 출하
- 2015.05 코스닥 라이징스타기업 선정

**2017 ~ 2021**

- 2017.11 (주)테스 원삼공장 가동(주소: 용인시 원삼면)
- 2021.12 제13회 대한민국 코스닥대상 수상
- **2021.12 연간 매출 3,700억원 달성**

**2022 ~ 현재**

- 2022.11 코스닥 글로벌 세그먼트 기업 지정
- 2024.05 소재, 부품, 장비 으뜸기업 선정
- **2025.02 Technology Park(R&D Center) 신축**
- 2025.07 라이징스타 명예의 전당 등재
- 2025.11 대한민국 코스닥대상 금융감독원 원장상 수상

# 01 Company Overview

## Location

### 사업장 (3)

용인 본사 (Semiconductor)

화성공장 (Display)

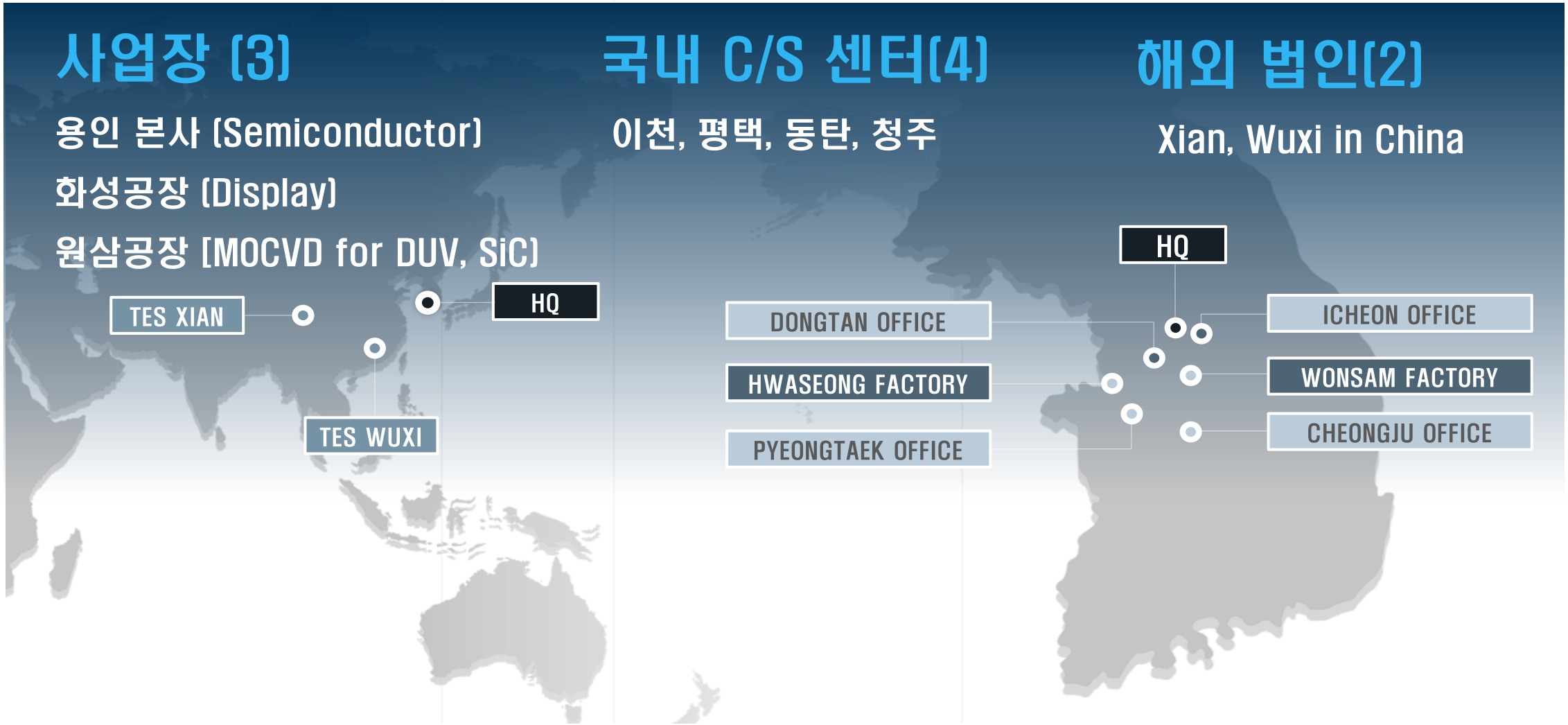
원삼공장 (MOCVD for DUV, SiC)

### 국내 C/S 센터(4)

이천, 평택, 동탄, 청주

### 해외 법인(2)

Xian, Wuxi in China



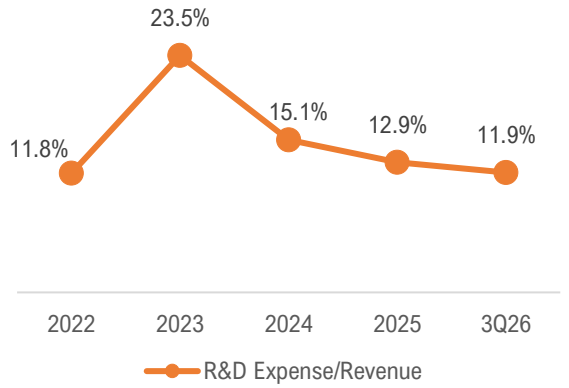
# 01 Company Overview

| Factory | 본사 | 원삼 공장 | 화성 공장 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 용인시 | 용인(원삼면) | 화성시 |
| 설립 | 2002 | 2017 | 2010 |
| 면적 | 8,585 ㎡ | 2,919 ㎡ | 3,597㎡ |
| 생산제품 | 반도체장비<br>(CVD & Dry Cleaning) | 반도체화합물장비<br>(Deep UV & SiC MOCVD) | 디스플레이장비<br>(PECVD & ALD for TFE OLEDoS) |
| Capacity | – 168 units/yr<br>Semiconductor Fab<br>– Semiconductor R&D Lab | – 25 units/yr<br>– OE Fab & R&D | – 24 units/yr<br>– Display Fab & R&D |
| 외관 |  |  |  |

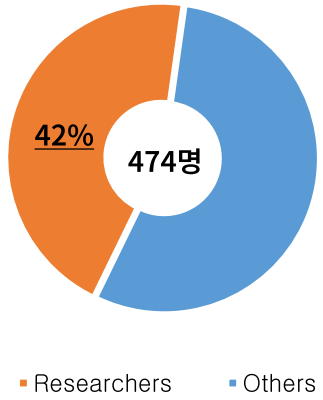
# 01 Company Overview

## R&D Overview

### R&D 비중




### 연구인력




### 시설

#### 제조설비 (CLASS 1000)



#### R&D (CLASS 100)




### 주요 측정 장비

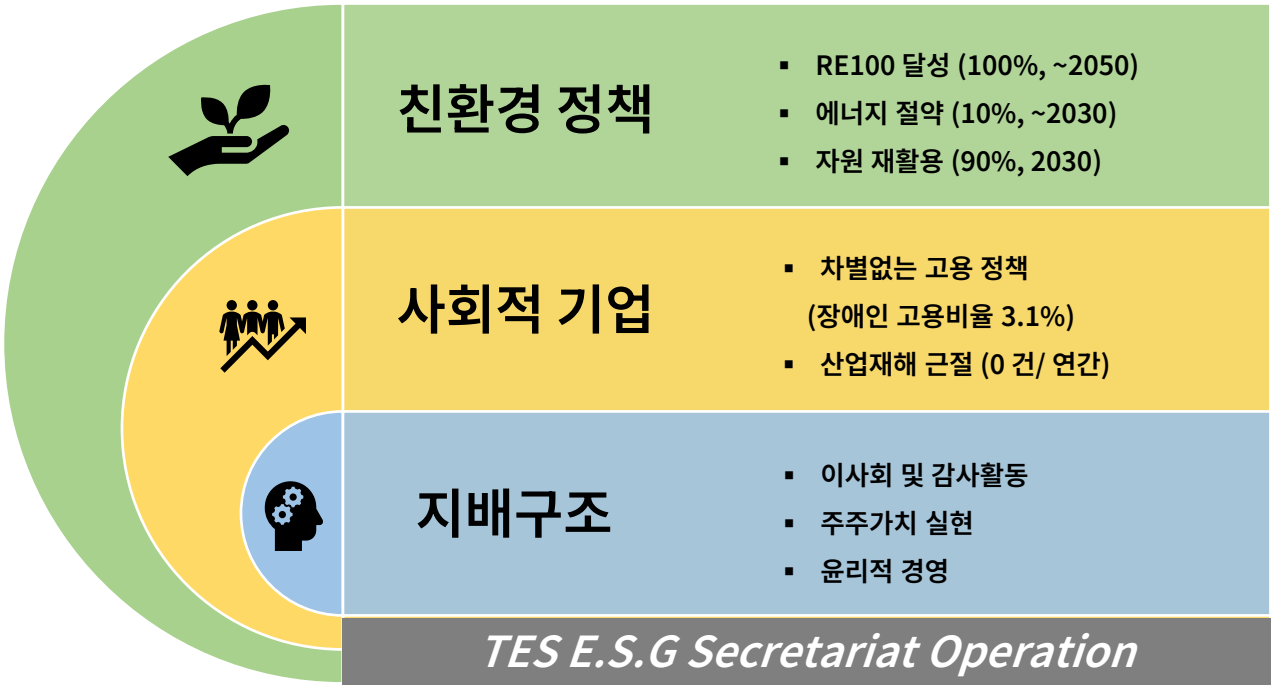
| No | 장비명 | 용도 |
|---|---|---|
| 1 | SP - 5 | Particle Measurement |
| 2 | TOF-SIMS | Analysis of Physical Properties |
| 3 | SEM | Surface Measurement |
| 4 | Nano Indenter | Thin film surface analysis |
| 5 | XRD | Structural Properties Measurement |
| 6 | FT-IR | Thin film composition analysis |
| 7 | Ellipsometer | Thin film thickness measurement |
| 8 | Particle Counter | Particle Measurement |
| 9 | 4 Point Probe | Thin film resistance measurement |
| 10 | Mercury Probe | C-V measurement |
| 11 | Wise Probe | V-I measurement |
| 12 | Smartest QMS | Gas analysis |
| 13 | Stress Gauge | Thin film stress measurement |
| 14 | LEI | Sheet Resistance Measurement |
| 15 | PL | Optical Properties Measurement |
| 16 | EL | Analysis of Electro Luminescence |
| 17 | ATLAS | Thin film thickness measurement |
| 18 | RGA | Gas analysis |
| 19 | MBIR | Thin film thickness measurement |

# 01 Company Overview

## Certifications / ESG

| 인증 목록 | |
|---|---|
| No | 인증 / 사양 |
| 1 | ISO9001 |
| 2 | ISO14001 |
| 3 | ISO45001 |
| 4 | ISO50001 |
| 5 | EMC Test |
| 6 | IEC 61439-2 Test |
| 7 | IEEE std. Test |
| 8 | SEMI F47 |
| 9 | SEMI S2 / S8 |
| 10 | SEMI S6 |

"2030년까지 탄소 배출량 15% 감축 및 2050년까지 Net Zero 달성"




TES ESG 등급 (2026, *KCGS)

| 구분 | 등급 |
|---|---|
| **종합** | **B+** |
| Environmental | B+ |
| Social | B+ |
| Governance | B+ |

*KCGS : Korea institute of Corporate Governance and Sustainability
(한국ESG기준원) / 총 평가대상: 1,090사
(유가 805사, 코스닥 219사, 비상장 66사)

# 02. Business Overview

# 02 Business Overview

## Products

| 사업분야 | Application | 주요고객 | 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|
| Semiconductor | Memory | 삼성전자<br>SK하이닉스 | AMAT<br>Lam Research<br>TEL | PECVD(Advanced ACL, Arc, Gap Fill, Low-K)<br>BSD System(BackSide Deposition)<br>EUV Layer System<br>Quad System(SiCN/SiN)<br>Dry Cleaning(GPE/RPE) |
| | Logic | 삼성전자 | | |
| Display & UV LED | | Tianma, CSOT, 삼성D<br>Epistar, Osram | AMAT, AMEC<br>Axitron | OLEDoS For XR<br>UV-MOCVD<br>Power Semiconductor(SiC/RF GaN Epi) |

# 02 Business Overview

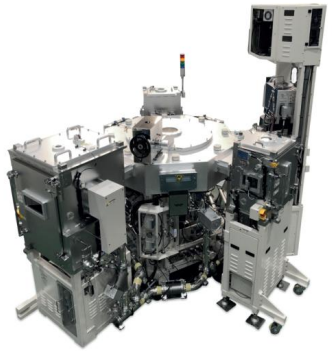
## Product Overview

### PE CVD
- Adv-ACL, ARC
- Gap Fill, EUV Layer
- SiCN, BackSide Deposition, Low-K



### Dry Clean
- GPE(Gas Phase Etch)
- RPE(Radical Plasma Etch)
- ALE(Atomic Layer Etch)





### Encapsulation PECVD
- OLEDoS For XR (AR & VR)

Semiconductor

Display

Opto Electronics

TES

Manufacturing Systems




### High Temperature MOCVD
- Power Semiconductor(SiC/GaN)
- Deep UV LED (UVB, UVC)

# 02 Business Overview

## Semiconductor Equipment



**CHALLENGER Series**

Adv-ACL, Gap fill,
ARC, EUV Layer

**CUMAX**

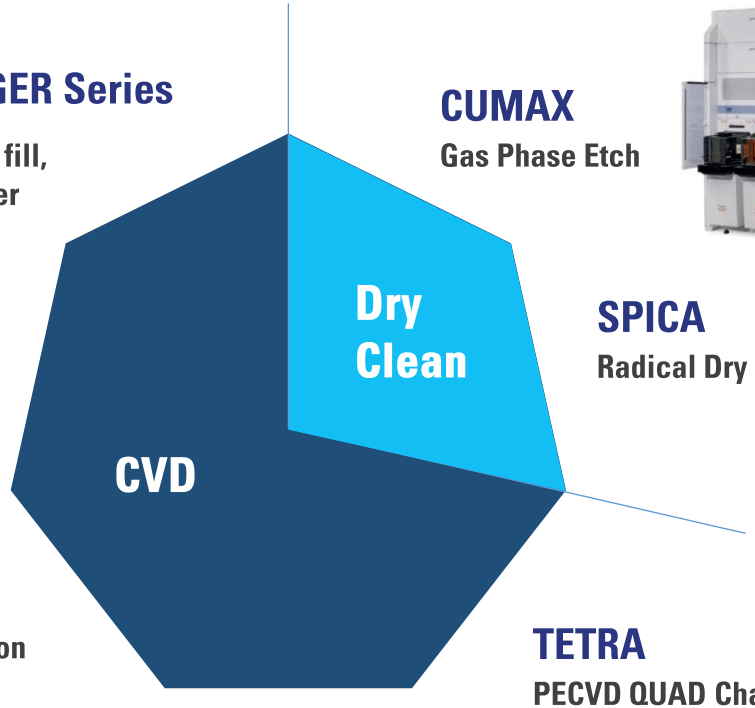
Gas Phase Etch





**SAIPH**

Low-k Oxide




**SPICA**

Radical Dry Clean



**KEID**

BackSide Deposition



**CYGNUS**

HD ACL



**TETRA**

PECVD QUAD Chamber



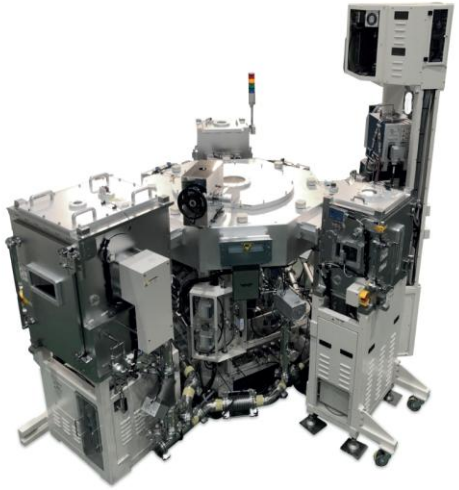
# 02 Business Overview

## OED Equipment




### SiC MOCVD

Power semiconductor
(EV, PSU, RF, Data Center)



### PECVD

XR(AR & VR) Micro OLED &
LED (8 inch & 12inch)

**OED Division**

### DUV MOCVD

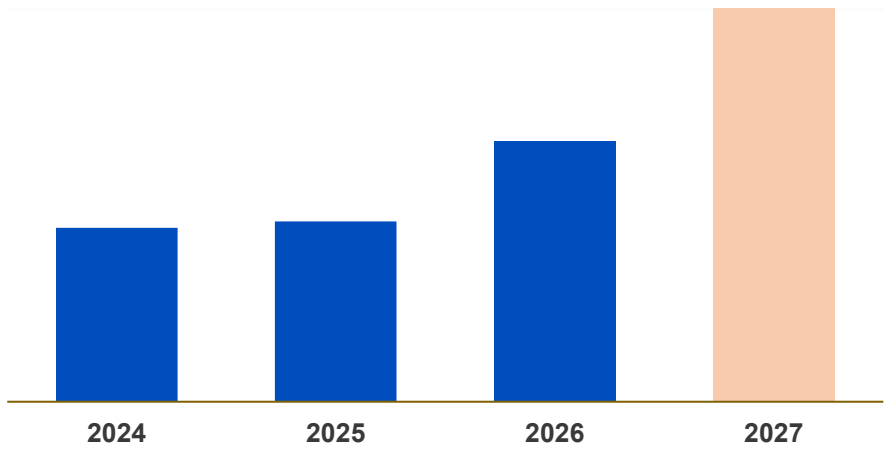
UVB & UVC LED epitaxy
growth



# Memory 반도체 ACL 장치 글로벌 과점 지위 확보 및 Adv. ACL 등 지속 증가

추정 환산 기준 : 2024년 → 2027E 점유율 상승

## 메모리 반도체 ACL Market Share(추정 %)




01 선단 공정 전환

02 Global Market Share 상승

03 적극적인 해외 Marketing

**DRAM/NAND 합산 ACL 장비 글로벌 M/S 30%+ 과점 지위 확보 및 점유율 확대 전망**

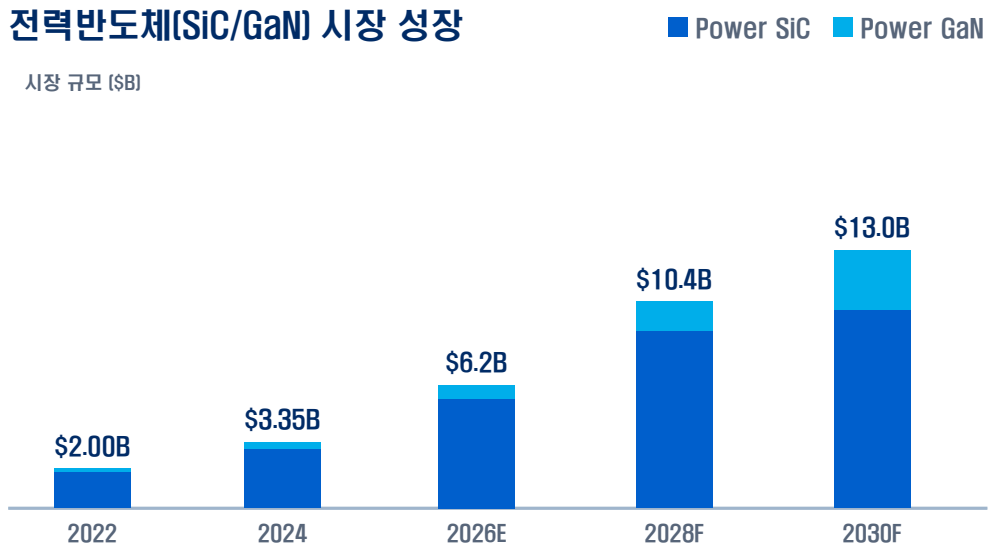
Source: TES Estimate / TrendForce

주: DRAM/NAND 글로벌 시장 비중과 TES ACL M/S를 적용한 추정치. 실제 장비 TAM 및 투자 mix에 따라 변동 가능.

# 전력반도체 고성장 사이클 대응 SiC/GaN EPI 성장 장비 개발

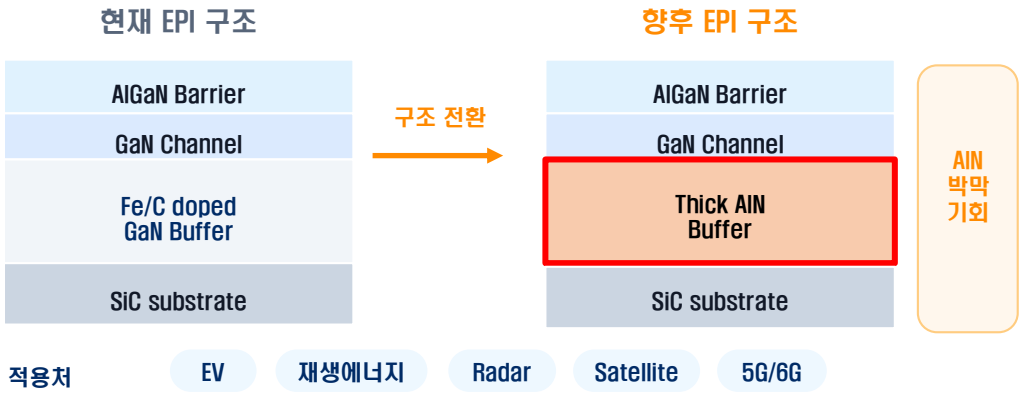
Power SiC · Power GaN 시장 확대와 GaN EPI 구조 변화 → 매출 다각화

## 전력반도체(SiC/GaN) 시장 성장




## GaN EPI 구조 변화: AlN 박막 수혜 포인트

고주파/전력 GaN 성능 고도화 과정에서 Buffer 구조 변화 → New BiZ 기회




1. **장비 개발** — SiC/GaN EPI 성장 장비
2. **시장 확대** — Power SiC · Power GaN 고성장
3. **구조 변화** — GaN EPI 내 AlN Buffer 채택
4. **수혜 가능성** — EPI/박막 공정 장비 수요 증가

**SiC/GaN EPI 장비 개발을 통해 전력반도체 성장과 AlN 박막 전환의 동시 수혜**

Source: Yole 2025 / TES 자료

# 03. Financial Result

# 03 Financial Results

## 3Q26 Earning Highlights

| 매출 | 영업이익 |
| --- | --- |
| 1,241억원 | 246억원 |
| + 83.7% YoY | + 192.5% YoY |
| **영업이익률** | **주당 순이익** |
| 19.8% | 650원 |
| + 7.4%p YoY | ▲ 5.8% YoY |

# 03 Financial Results

## 3Q26 Result

### 26년 3분기 실적

■ 메모리 고객사 신규 Fab 및 Tech 전환 투자

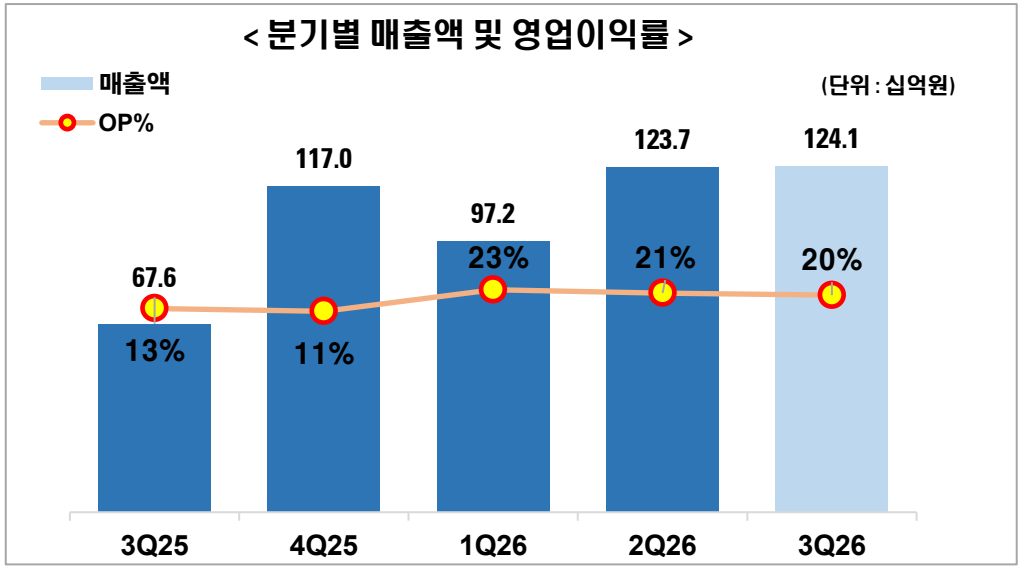
- 매출액 1,241억원(QoQ +0.4%/ YoY +83.7%)
- 영업이익 246억원(QoQ ▲5.4%/ YoY +192.5%)
- 순이익 120억원(QoQ ▲64.9%/ YoY ▲1.2%)

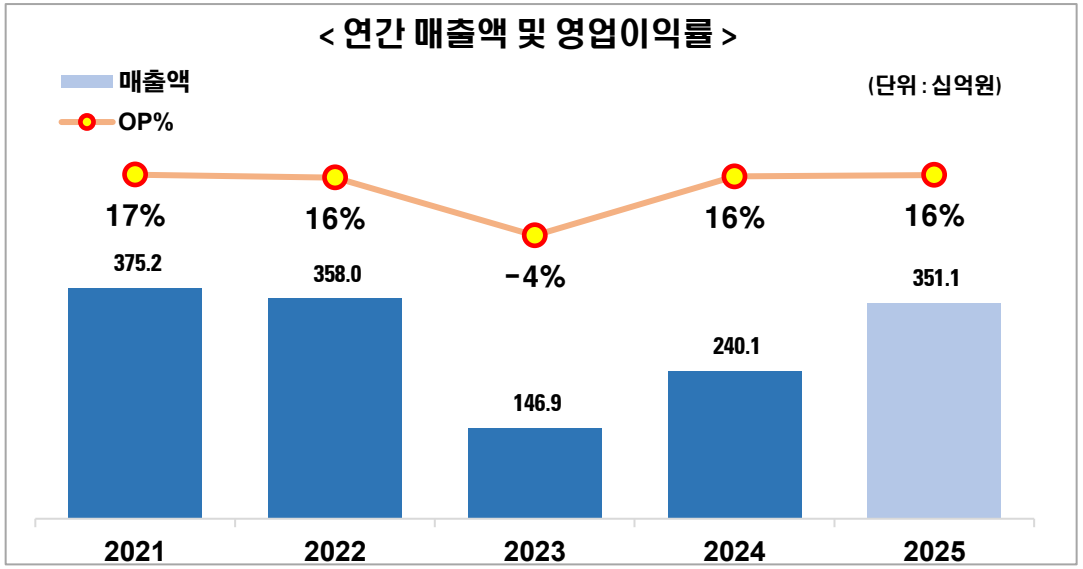
### 향후 전망 / 추진 전략

■ 27년 메모리 고객사 신규 Fab 증설 및 전환 투자 지속

■ 신제품 개발 및 매출 증가

■ 해외 Marketing 강화 및 해외 고객사 매출 증가



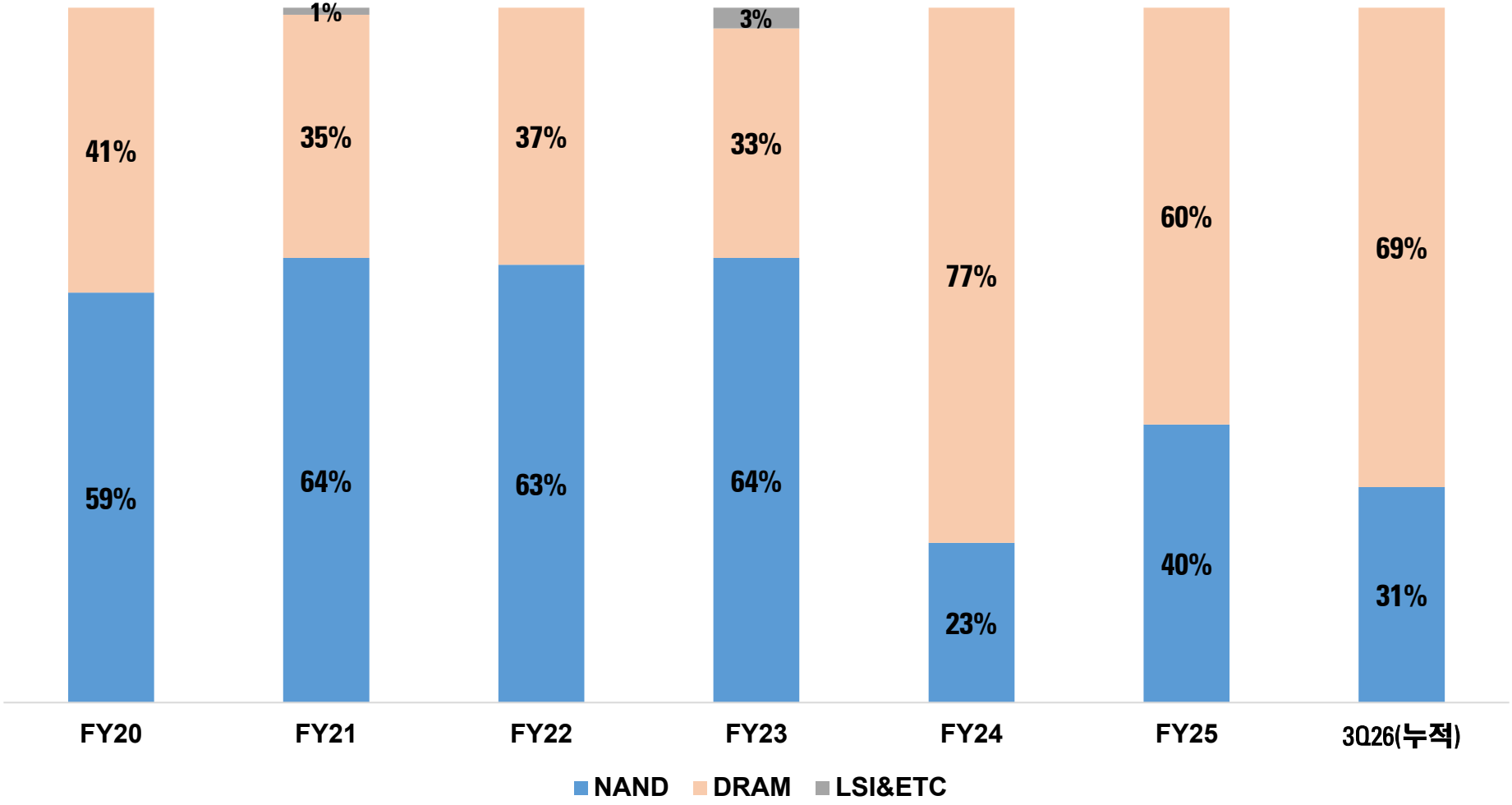
# 03 Financial Results

## 3Q26 Financial results

| (단위: 백만원) | 3Q25 | 2Q26 | 3Q26 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67,568 | 123,671 | 124,142 | 0.4% | 84% |
| 영업이익(손실) | 8,416 | 26,027 | 24,614 | △5% | 192% |
| OP % | 12% | 21% | 20% | △1%p | +8%p |
| 법인세차감전순이익 | 13,891 | 42,945 | 13,725 | △68% | △1% |
| 당기순이익 | 12,101 | 34,030 | 11,955 | △65% | △1% |
| 주당순이익 (단위: 원) | 690 | 1,833 | 650 | △65% | △6% |

# 03 Financial Results

## Sales by Application



# 03 Financial Results

## Competitive Edge

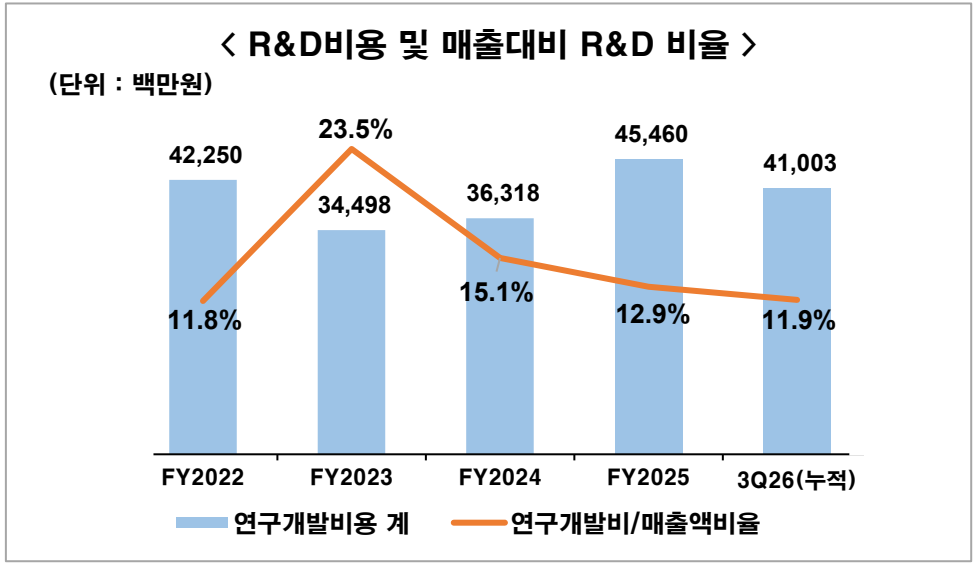
### 개발 지향

**(1) Competitive edge**

- PECVD & Dry Cleaning 장치 독보적 기술력 보유
- 우수한 품질, 가격, 서비스

**(2) R&D 비율**

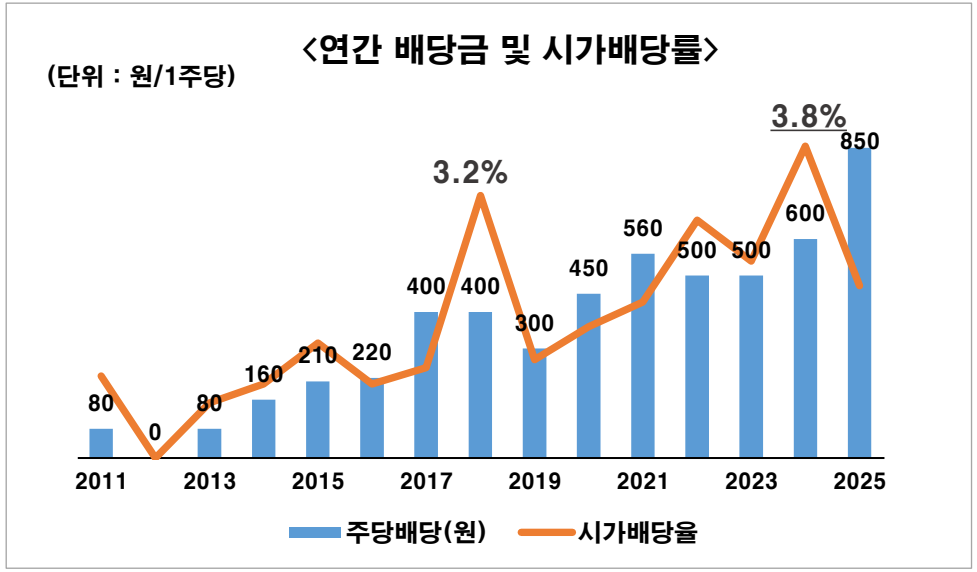
- 성장을 위한 R&D 지속
- 매출의 10% 이상 R&D




### 주주환원

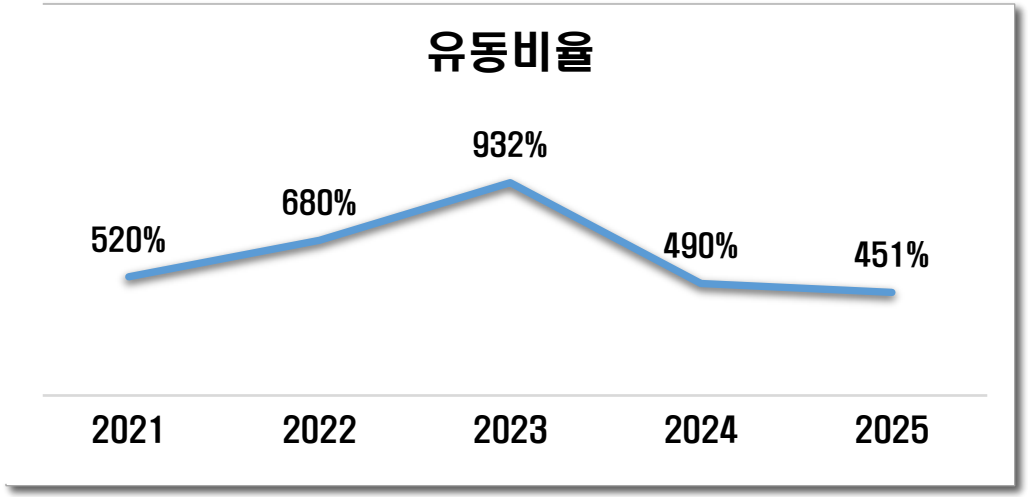
**(1) 주주배당**

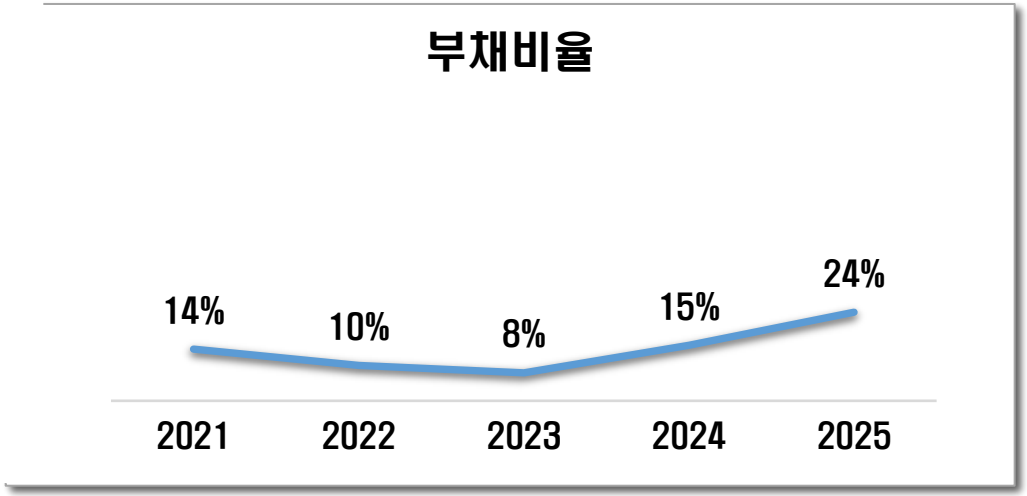
- 13년 연속 배당
- 배당금 및 시가배당률 장기 우상향

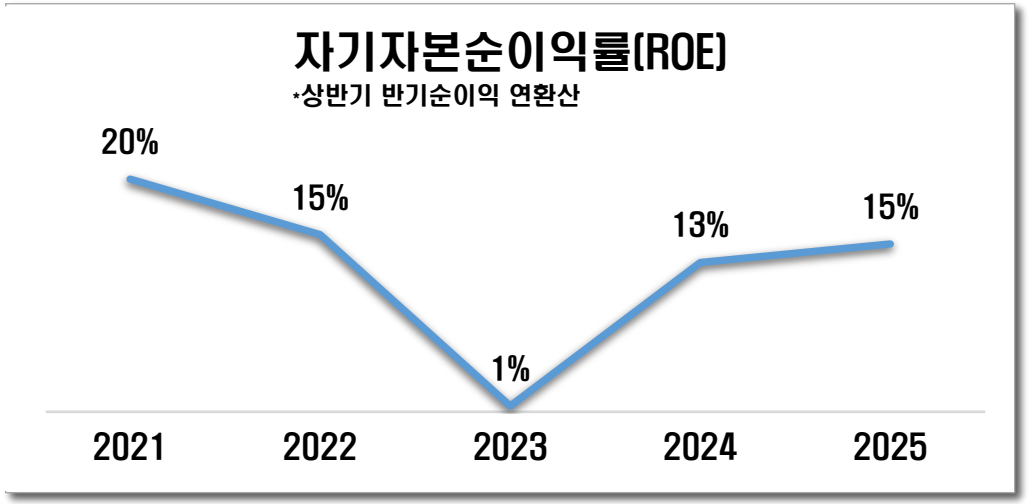


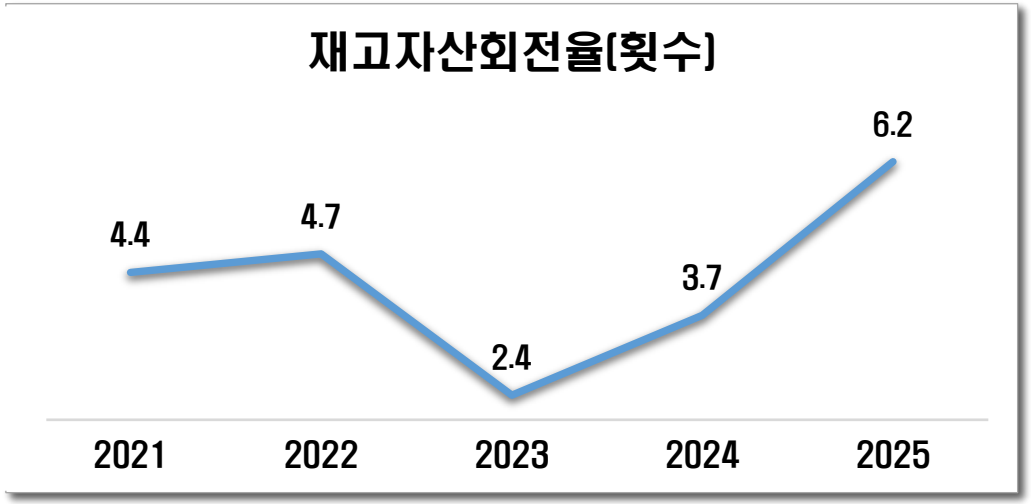
# 03 Financial Results

## Financial Ratios



# 04. Appendix

# 04 Appendix

## Income Statement

| (단위: 백만원) | 3Q25 | 2Q26 | 3Q26 | QoQ | YoY | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **매출액** | 67,568 | 123,671 | 124,143 | 0.4% | 84% | 146,938 | 240,078 | 351,116 |
| 매출원가 | 52,050 | 87,149 | 89,270 | 2% | 72% | 134,131 | 175,503 | 259,011 |
| **매출총이익** | 15,519 | 36,522 | 34,873 | △5% | 125% | 12,807 | 64,574 | 92,104 |
| 판매비와관리비 | 7,103 | 10,496 | 10,258 | △2% | 44% | 18,669 | 26,101 | 34,266 |
| **영업이익(손실)** | 8,416 | 26,027 | 24,615 | △5% | 192% | △5,862 | 38,474 | 57,838 |
| 영업외손익(Net) | 5,474 | 16,919 | *△10,890* | △164% | △299% | 8,130 | 11,361 | 7,928 |
| 세전이익 | 13,891 | 42,945 | 13,724 | △68% | △1% | 2,268 | 49,835 | 65,766 |
| **당기순이익** | 12,101 | 34,030 | 11,955 | △65% | △1% | 1,566 | 42,654 | 56,918 |
| | | | | | | | | |
| 매출총이익률( %) | *23%* | *30%* | *28%* | *△2%p* | *+5%p* | *9%* | *27%* | *26%* |
| 영업이익률(%) | *12%* | *21%* | *20%* | *△1%p* | *+8%p* | *△4%* | *16%* | *16%* |
| 당기순이익률(%) | *18%* | *28%* | *10%* | *△18%p* | *△8%p* | *1%* | *18%* | *16%* |

# 04 Appendix

## Statement of Financial Position

| (단위: 백만원) | 3Q25 | 2Q26 | 3Q26 | QoQ | YoY | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **자산총계** | 456,070 | 565,943 | 573,981 | 1% | 26% | 321,830 | 381,187 | 487,649 |
| 유동자산 | 228,340 | 292,317 | 283,897 | △3% | 24% | 194,322 | 183,222 | 215,352 |
| 현금 및 현금성자산 | 52,524 | 65,864 | 33,245 | △50% | △37% | 127,891 | 11,650 | 12,143 |
| 매출채권 및 기타채권 | 12,403 | 29,555 | 35,067 | 19% | 183% | 12,217 | 38,458 | 26,948 |
| 재고자산 | 55,353 | 58,225 | 69,042 | 19% | 25% | 53,020 | 41,189 | 42,820 |
| 기타자산(유동) | 108,060 | 138,673 | 146,543 | 6% | 36% | 1,194 | 91,925 | 133,441 |
| 비유동자산 | 227,730 | 273,626 | 290,084 | 6% | 27% | 127,508 | 197,965 | 272,117 |
| 금융상품(비유동) | 37,640 | 24,663 | 34,758 | 41% | △8% | 49,844 | 31,471 | 32,720 |
| 유무형자산 | 140,128 | 147,326 | 148,038 | 0% | 6% | 67,567 | 117,710 | 144,083 |
| 기타자산(비유동) | 49,962 | 101,637 | 107,288 | 6% | 115% | 10,097 | 48,784 | 95,314 |
| **부채총계** | 85,369 | 98,309 | 91,941 | △6% | 8% | 22,931 | 50,649 | 95,715 |
| 유동부채 | 51,100 | 82,529 | 79,875 | △3% | 56% | 20,857 | 37,380 | 47,711 |
| 비유동부채 | 34,269 | 15,780 | 12,066 | △24% | △65% | 2,074 | 13,269 | 48,004 |
| **자본총계** | 370,700 | 467,634 | 482,040 | 3% | 30% | 298,899 | 330,538 | 391,754 |
| 자본금 | 9,884 | 9,884 | 9,884 | 0% | 0% | 9,884 | 9,884 | 9,884 |
| 이익잉여금 등 | 360,816 | 457,750 | 472,156 | 3% | 31% | 289,015 | 320,654 | 381,870 |

# Thank you



Create Future!
TES
Technology Engine of Science